

Требования по документации к печатным платам и комплектации

По документации:

- Файл проекта в cad-форматах, (если платы в заготовке, то должен быть файл мультиплицированной заготовки).
- Сборочный чертеж или монтажную схему с указанием позиционных обозначений, полярностей или ключей элементов (если требуется). Также должны быть указаны высоты установки компонентов, способы формовки и т.д. В отсутствии таких указаний монтаж ведется по нашему усмотрению.
- Спецификация (перечень элементов) с указанием полного однозначного наименования компонентов, позиционного обозначения, номиналов и типа корпуса. Перечень элементов должен точно соответствовать файлу проекта и сборочному чертежу (монтажной схеме) по позиционным обозначениям, перечню комплектации и номиналам, с указанием не устанавливаемых компонентов (если необходимо). Также желательно указать допустимые замены.
- Для ускорения обработки комплектации к заказу необходимо предоставить обобщенный перечень элементов.

По комплектации:

- Комплектация для SMD-монтажа должна поставляться в лентах, поддонах, пеналах, линейках (заводских упаковках). Носители должны быть стандартными, целиковыми, не смятыми. Детали в этих носителях должны быть ориентированы по ключу элемента в одну сторону (проверка ориентирования ключей на производстве не осуществляется без дополнительных требований).
- Ленты должны быть намотаны на катушки (перфорация слева от себя - стандартный вариант у производителей).
- Ленты на катушках должны быть целиковыми, без повреждений перфорации, без склеек скотчем и без заломов, и должен иметь заправочный конец длиной не менее 35мм. Номинал компонента должен быть указан на катушке четким, читаемым шрифтом.
- Компоненты, особенно многовыводные микросхемы, россыпью не принимаются.
- Комплектация для SMD-монтажа должна поставляться с учетом технологического запаса: 2% компонентов одного номинала, для крупных элементов не менее 2 шт.
- Детали для DIP монтажа должны быть в упаковке с однозначной маркировкой типа и номинала четким, читаемым шрифтом.
- Комплектация для DIP монтажа должна поставляться с учетом запаса: 1шт одного номинала.
- Элементы должны храниться в соответствии с требованиями по хранению и в оригинальной упаковке. Не принимаются элементы с коррозией, окислением, подмаканием, деформацией.
- Комплектация принимается только с сопроводительными документами (накладная).

ВНИМАНИЕ!

Подрядчик, не занимается проверкой качества компонентов и упаковки, переданных заказчиком. И, в случае несоблюдения требований, оставляет за собой право или отказаться от выполнения заказа, или увеличить сроки и стоимость выполняемых работ.

По печатным платам:

- На печатных платах должны быть технологические поля с двух сторон, параллельных друг другу. Ширина технологического поля не менее 5 мм. Если плата не прямоугольная, то технологические поля 5 мм должны быть с 3-х сторон мультиплицированной заготовки.
- На каждой плате должны быть нанесены реперные знаки. Они не должны располагаться на технологических полях. Два различных знака (например, круг и квадрат) должны располагаться в двух диагональных углах платы. Если невозможно установить реперные знаки или их установка вызывает вопросы, необходимо проконсультироваться с нашими специалистами.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих требований может служить основанием для отказа от выполнения работ или увеличения сроков и стоимости.

Технические условия монтажа по умолчанию:

- По умолчанию используется свинцовая безотмывная паяльная паста.
- При DIP-монтаже используется ПОС61 (ПОС63) и водосмывной флюс.

Дополнительные требования к монтажу (если необходимо):

- Применение свинцовой водоотмывной, безсвинцовой паяльной пасты.
- Необходима ли пайка нейтральными флюсами (для DIP монтажа).
- Установка элементов на высоту (для DIP монтажа).
- Формовка элементов (для DIP монтажа).
- Разделение плат после монтажа.
- Образец кабелей, жгутов.
- Специальные требования к упаковке.
- Механическая доработка.